



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

深圳信维通信股份有限公司 样品承认书

客户名称: OPPO

项目编码: AC179

项目名称: 无线充电线圈

厂家型号: 1100020966

版本号: A0

供应商:责任人	签字	签样日期
RF 工程师		
ME 工程师		
质量工程师		
项目经理		

客户: 责任人	签名	签样日期
PE-T 工程师		
SQE 工程师		
NFC 工程师		
WPC 工程师		
ME 工程师		



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

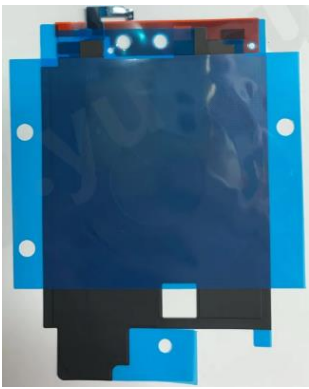
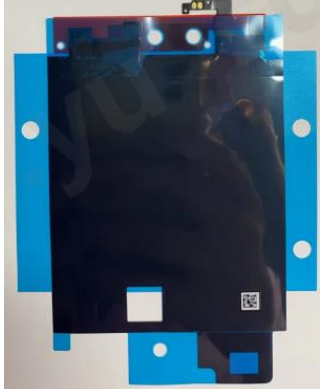
目录

[TABLE OF CONTENTS]

1. 承认书封面.....	01
2. 目录.....	02
3. 基本信息.....	03
4. 修改履历.....	03
5. 产品图纸.....	04
6. FPC 设计评审 checklistV1.0.....	05
7. 可靠性.....	07
8. 物料清单.....	08
9. 堆叠厚度.....	09
10. 尺寸报告.....	10
11. 电性规格	11
12. 变更履历.....	12
13. 出货包装规范.	13



3. 基本信息

产品名称	CP057_WPC	产品图片	
		正面	反面
信维料号	1100020966		
产品单重	约 2.84g		
生产地	常州		
样品类型	RX		

4. 修改履历

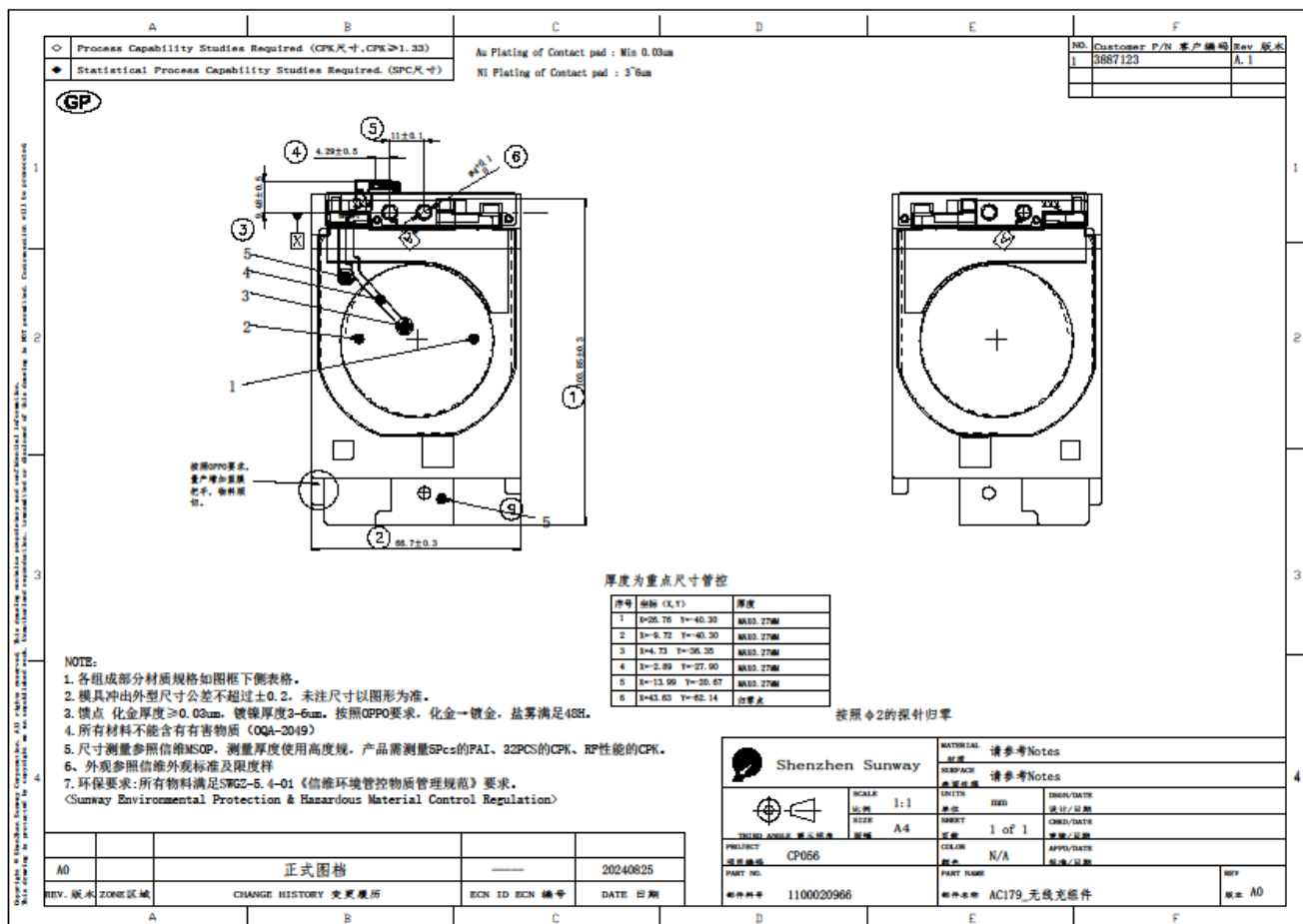
Rev.	Date	Before	After	Remark
1.0	2024.08.14	/	/	初版发行



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

5.产品图纸





深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

6. FPC 设计评审 checklistV1.0

软硬结合板（摄像头除外）及FPC设计评审checklist V1.4

序号	项目	标准要求	结果 (实际值)	结论 (OK/NG/NA)	备注
1	供应商选择	FPC供应商选择需满足OPPO《间接FPC供应商选择白名单及硬性要求》要求，否则不能发板。	晓鸽	OK	
2	资料提供	FPC板厂需要提供量产GERBER各层资料（包括线路层、COVERLAY层、防焊油墨层、补强板层、EMI层、文字油墨层、背胶层、外型模具层）给OPPO确认，OPPO认可后方可发板。 FPC板厂需要提供按图示格式提供叠层结构图。		OK	
3	提供资料要求			OK	
4	提供资料要求	FPC板厂需要提供2D图纸&3D图纸，可以看到PCB/R-FPC/FPC的所有尺寸要求、铜厚要求、金镍厚度要求、环保要求、弯折要求、装配效果图等。	 金镍厚度要求：按照要求化金，金厚MIN0.03um，镍厚：3.0~6.0um 环保资料，由我司品质提供。	OK	
5	提供资料要求	FPC板厂需要提供PCB/R-FPC/FPC的MIPI阻抗仿真信息。	无MIPI阻抗要求	OK	
6	材料选择	材料品牌需要符合OPPO间接材料选择AVL。	请见环保资料	OK	
7	材料选择	材料选择的型号需要为板厂常用材料（材料的型号推出市场3年以上，并且在同类型产品上使用量达到10万平米或者5KXpcs以上），不能使用专供OPPO的材料。	符合	OK	
8	材料选择	弯折区如果要采用油墨（屏的ACF手指单层次比较多这种设计，1.耐弯折；2.降低反弹力），则必须采用耐弯折油墨（可通过50次直径1.0mm正反180度弯折）。	弯折区采用覆盖膜	OK	
9	材料选择	产品是否有新材料/新工艺/新技术？有的话需要针对新材料/新工艺/新技术做DOE验证、可靠性测试，评估过量产可行性。	无	OK	
10	材料选择	除NFC天线允许选择有胶铜外，其它所有FPC都只能选择无胶铜。无胶基材禁止选用TP1的TG点小于280度的材料。	符合	OK	
11	材料选择	补强板粘接用的热固导电胶只能选择60um厚的胶，单个接地开窗的直径或者长宽≤1.00mm或者接地阻值≤3欧姆时只允许使用拓自达CBR800-W60和东洋TSC200-W60。	未使用热固导电胶	OK	
12	材料选择	铜片补强板粘接用的热固非导电胶禁止选用东瑞F25纯胶（此胶过高温高温后剥离力下降厉害）。	无	OK	
13	材料选择	从试产开始到量产结束，FPC的主材与辅材变更要书面提交PCN变更申请。	暂无	OK	
14	叠层结构	FPC板厂需要提供量产叠层结构资料（包括各层理论厚度、压合后的厚度、镀铜厚度、材料品牌与型号、不同区域的厚度与公差）给OPPO确认，OPPO认可后方可发板。		OK	
15	叠层结构	叠层结构中的孔内镀铜厚度应大于OPPO要求的过孔平均铜厚。	>10um	OK	
16	叠层结构	盲孔最大深度应≤80um。	无盲孔	OK	
17	叠层结构	盲孔最大纵径应≤0.6；1（孔深、孔径）。	无盲孔	OK	
18	叠层结构	导通孔最大纵径应≤4；1（板厚、孔径）。	无导通孔	OK	
19	叠层结构	当选用盲埋孔设计时，盲孔需要镀铜填孔处理，且填孔Dimple应满足“表层≤20um，内层≤15um”的设计要求。	无盲埋孔	OK	
20	叠层结构	多层FPC弯折区应采用分层去胶处理，以提高弯折区柔韧性。	双面板	OK	
21	叠层结构	双层板弯折区需要做网格，以提高弯折区柔韧性。	无需做网格处理	OK	
22	叠层结构	弯折区的弯折半径需要设计成大于板厚的3倍，空间不足时，需要在弯折位置做缓冲设计（如点胶、加泡棉、加垫片）。	无	OK	
23	叠层结构	邦定区金手指到弯折区的油墨与邦定区金手指背面的覆盖膜的重合度要≥0.3mm。	 无绑定金手指设计	OK	
24	叠层结构	软硬结合板盲孔禁止设计成激光直接烧PP+覆盖膜（硬板区盲孔边缘需盖膜边0.3mm），软板区的覆盖膜只允许铺到与硬板区重叠0.5mm。	双面板	OK	
25	叠层结构	当R-FPC选用1+2+1的HDI盲埋孔设计时，内层（L2-3）埋孔全板电镀会导致FPC铜厚增加，弯折柔韧性降低，采用选镀又有干膜污染电镀缸及夹膜的风险，所以，对弯折柔韧性有特殊要求的项目，可以采用1+1+2+1的6层R-FPC叠构，盲孔采用L1-2、L5-6设计，埋孔采用L2-5设计。	双面板	OK	
26	叠层结构	100Q MIPI阻抗，PCCL优先选用1/3盎司铜厚、25um PI的无胶基材； 90Q MIPI阻抗，PCCL优先选用1/3盎司铜厚、20um PI的无胶基材； 以提升软板柔韧性，降低钻孔扯胶导致过孔不良的机率。	无阻抗线	OK	
27	叠层结构	R-FPC内层不做电镀铜的CoverLay应选用15um的胶厚，12.5um厚的PI。	双面板	OK	
28	叠层结构	FPC、R-FPC的CoverLay胶厚应大于所选基材铜箔加电镀铜的70%厚度，否则容易产生高温起泡问题。	按贵司覆盖膜材料要求	OK	
29	叠层结构	二标的叠层结构必须与一标保持一致。	/	OK	
30	叠层结构	指纹FPC除侧边指纹及结构特殊要求外，优先选择不减铜工艺； 侧边指纹FPC优先选择ED铜+面镀工艺。	非指纹FPC	OK	
31	孔设计	器件PAD上尽量不要打过孔；盲孔需要从PAD背面打孔。	无器件	OK	



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

32	孔设计	空间允许时,过孔设计必须做双孔设计,增加可靠性。	双孔设计	OK	
33	孔设计	盲孔孔径/孔环 $\geq 75\mu\text{m}/220\mu\text{m}$ 。	无盲孔	OK	
34	孔设计	双面PCB通孔最小孔径/孔环:100um/300um。	200um/200um	OK	
35	孔设计	多层板优先采用机械钻孔,板厚 $<0.3\text{T}$,最小孔径 $>100\mu\text{m}/300\mu\text{m}$;板厚 $>0.3\text{T}$,最小孔径 $>150\mu\text{m}/350\mu\text{m}$;	0.2mm	OK	
36	孔设计	导通孔优先选用 $>0.15\text{mm}$ 机械钻孔,0.1mm及以下直径的钻孔优先选用镭射钻孔。	0.2mm	OK	
37	孔设计	信号线的孔禁止打在弯折区,需要高弯折区 $>1\text{mm}$ 。	孔不在弯折区	OK	
38	孔设计	信号线的孔高补强边 $>0.3\text{mm}$ 。	孔高补强边 $>0.3\text{mm}$	OK	
39	线路设计	常规线路线宽首件监控中幅=(上幅+下幅)/2,控制至规格中心;ACP手指处线宽首件监控上幅,控制在规格中心值以上。	按规格中心监控	OK	
40	线路设计	外层走线:线宽/线距 $>75\mu\text{m}/75\mu\text{m}$ (总铜厚 $<35\mu\text{m}$);线宽/线距 $>60\mu\text{m}/60\mu\text{m}$ (总铜厚 $<30\mu\text{m}$);线宽/线距 $>50\mu\text{m}/50\mu\text{m}$ (总铜厚 $<25\mu\text{m}$);	双面板	OK	
41	线路设计	内层走线:线宽/线距 $>50\mu\text{m}/50\mu\text{m}$ 。	双面板	OK	
42	线路设计	软板弯折区,细线走中间,粗线走两边,地铜走最外面,尽量保证左右对称。	左右对称	OK	
43	线路设计	软板弯折区,左右两侧应加防撕裂线设计,防撕裂线宽度 $>0.2\text{mm}$ 。	无	OK	
44	线路设计	所有走线拐角处需要做圆角处理,走线与PAD连接处需要做泪滴处理。	有圆角处理	OK	
45	线路设计	线路或者PAD的空旷区要特别补偿,防止线路蚀刻过细。	是	OK	
46	线路设计	双面板的焊盘如果靠近双面交界位置,需要特别加宽泪滴,泪滴初始宽度 $>$ 焊盘宽度的3/4,防止焊盘开口边缘断线。	无焊盘在交界位置	OK	
47	线路设计	走线与外型的间距,地铜需要 $>0.2\text{mm}$,信号线 $>0.3\text{mm}$ 。	$>0.2\text{mm}$	OK	
48	线路设计	宽度为0.2mm以下的独立地铜丝,必须剔除。	无独立地铜丝	OK	
49	线路设计	孔及焊盘加焊锡,必须平滑过渡,过渡过程不可有拐角。	OK	OK	
50	线路设计	铜板+芯片能过原材料进行镀铜,禁止镀铜后再镀铜。	无镀铜工艺	OK	
51	线路设计	线路蚀刻按理论值 $\pm 20\%$ 管控,阻抗线路按理论值 $\pm 10\%$ 管控。	满足	OK	
52	线路设计	PPC蚀刻设计线宽不能小于50um,成品的实际线宽需要 $\geq 55\mu\text{m}$ 。	线宽大于50um	OK	
53	线路设计	阻抗(MIPIT)线的EMI区域的参考层设计规范,没有EMI的区域阻抗参考层可以走实铜,有EMI的区域阻抗走网络铜。	无阻抗线	OK	
54	线路设计	阻抗(MIPIT)线背面时参考地方制定规格、实铜、半铜、EMI、铜补强时,如果实测阻抗有超标,需要变更线宽去做阻抗匹配	无阻抗线	OK	
55	SolderMask	有油墨开窗的焊盘,优先采用on-pad设计。	油墨阻焊	OK	
56	SolderMask	阻焊油墨开窗区域,覆盖膜与油墨重叠 $>0.3\text{mm}$ 。	0.4mm	OK	
57	SolderMask	覆盖膜接地开窗需要与相邻不同网络的线路、孔盘保持 $>0.3\text{mm}$ 的安全距离,阻焊油墨接地开窗需要与相邻不同网络的线路、孔盘保持 $>0.15\text{mm}$ 的安全距离,防止露线短路。	无接地开窗	OK	
58	SolderMask	覆盖膜颜色优选黄色,正背面覆盖膜相同位置的开窗需错开 $>0.2\text{mm}$ 。	黑色覆盖膜,无正背面覆盖膜在同一位置开窗	OK	
59	SolderMask	同一面除BTP外无其他器件,开窗方式优先选择覆盖膜。	无器件	OK	
60	SolderMask	所有器件在同一面,另一面接地开窗优先选择钻孔方式,以节省开窗成本。	无器件	OK	
61	SolderMask	HotBar焊接或者手工焊接等双面焊接的焊盘PAD的开窗要做成曲面的开窗,防止双面直线开窗容易折裂焊盘边缘线路的问题。	无需做波浪形开窗	OK	
62	SolderMask	①覆盖膜焊盘开窗,NSMD焊盘设计时,过孔PAD边、走线不同网络的器件焊盘边的间距 $>0.3\text{mm}$;SMD焊盘设计时,过孔PAD边、走线不同网络的器件焊盘边的间距 $>0.15\text{mm}$; ②阻焊油墨焊盘开窗,NSMD焊盘设计时,过孔PAD边、走线不同网络的器件焊盘边的间距 $>0.15\text{mm}$;SMD焊盘设计时,过孔PAD边、走线不同网络的器件焊盘边的间距 $>0.075\text{mm}$ 。	SMD焊盘设计,距离 $>0.15\text{mm}$	OK	
63	SolderMask	覆盖膜偏位控制 $\leq 0.15\text{mm}$;防焊油墨偏位控制 $\leq 0.05\text{mm}$ 。	符合覆盖膜偏位控制 $\leq 0.20\text{mm}$	OK	
64	SolderMask	油墨与覆盖膜重合区域,油墨+覆盖膜厚度小于60um。	小于60um	OK	
65	SolderMask	摄像头阻焊油墨需要 $>30\mu\text{m}$,其它物料的阻焊油墨厚度需要 $\leq 30\mu\text{m}$ 。选镀孔阻焊需要增加面塞流程	此项目不是摄像头	OK	
66	SolderMask	铜补下方的阻焊接地开窗设计,禁用把地铜全部开窗,只允许开2-3个方形或有圆角局部开窗,开窗大小 $>0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm}$ 。	无铜片,不需接地开窗	OK	
67	SolderMask	增加油墨绝缘性能需要用塞孔,或者两次印刷油墨油墨的方式,禁止采用在过孔位置印刷点状油墨的方法增加绝缘性能。	印刷油墨	OK	
68	补强设计	如果焊盘开窗会用到油墨,则背面补强板边缘与油墨开窗的重合度 $>0.65\text{mm}$,补强板与覆盖膜开窗的重合度 $>0.5\text{mm}$;如果焊盘开窗是覆盖膜单独开窗,则背面补强板边缘与覆盖膜开窗的重合度 $>0.50\text{mm}$ 。	油墨阻焊,补强板与覆盖膜开窗的重合度要 $>0.55\text{mm}$	OK	
69	补强设计	实际生产加工时,算上补强板内缩和覆盖膜开窗补偿的影响,补强板边缘与覆盖膜开窗的重合度要 $>0.4\text{mm}$ 。			
70	补强设计	铜片补强有接地需求,图纸没规定阻值时,常规接地电阻需要 $\leq 5\Omega$ 。	无铜片,不需接地开窗	OK	
71	补强设计	同一面的补强板相隔距离小于1mm时,补强边缘 $\pm 0.5\text{mm}$ 的位置需要做成网格(电源线与信号线不可做成网格),防止覆盖膜产生气泡。	只有一块补强	OK	
72	补强设计	同面的两块补强间距 $\geq 1\text{mm}$,不同面的两块补强间距 $>0.5\text{mm}$ 。	只有一块补强	OK	
73	补强设计	蚀刻铜补强的微连接断点需要放在地铜区域,避开线路。	无铜片	OK	
74	补强设计	冲型铜补强的毛刺面需要背高线路。	无铜片	OK	
75	补强设计	补强板铜厚 $<0.15\text{mm}$ 。	符合要求	OK	
76	补强设计	FR4补强毛刺 $<0.1\text{mm}$ 。	无FR4补强	OK	
77	补强设计	铜补强毛刺 $<0.05\text{mm}$ 。	无铜片	OK	
78	EMI设计	铜补强相对外型的内缩设计需要控制在0.1mm-0.2mm之间。	无铜片	OK	
79	EMI设计	增加油墨绝缘性能需要用塞孔,或者两次印刷油墨油墨的方式,禁止采用在过孔位置印刷点状油墨的方法增加绝缘性能。	无EMI	OK	
80	EMI设计	EMI的接地开窗 $>0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm}$ 。	无EMI	OK	
81	表面处理	常规镀金规格: 焊接和粘接区域Au 0.03um-0.125um, N1 2.5-6um; 弹片接触PAD Au 0.05um-0.2um, N1 2.5-6um; ACP邦定金手指Au 0.05um-0.2um, N1 2-6um。 ENHPIG规格: Au $>0.05\mu\text{m}$, Pd $>0.05\mu\text{m}$, N1 3-8um。 常规OSP规格: 0.2-0.5um。	化锡金,金厚 $>0.03\mu\text{m}$,镍厚:3.0*6.0um	OK	
82	表面处理	常规金面需要通过24小时中性盐雾,有特殊要求要过48小时中性盐雾的产品,可以使用封孔剂。	符合	OK	
83	文字设计	文字在有空间的情况下,不要放在弯折区。		OK	
84	文字设计	文字只作标识作用时,优先考虑蚀刻或mark方式代替文字。		OK	
85	外形设计	PPC外形不超出最外侧器件、Pad、压接手指外形边缘,中间走线优先按L/L直线型设计。	符合	OK	
86	追溯工艺	产品追溯需要在每PCS产品上增加lot号(80-150PWL)的投料批次流水号)和拼板的位置码。	无	OK	



7. 可靠性

可靠性	
1	高温高湿: 85℃, 85%RH, 96H
2	冷热冲击: -40℃, 30min, 85℃, 30min, 100cycle
3	盐雾测试: 盐雾浓度 5%, 35℃, 24H
结果	
	WPC@100kHz
Ls	4.68~4.98
Rs	<300mΩ
测试频率	
10PCS/月	

性能数据

No.	Ls/uH	Rs/mΩ	Rdc/mΩ	Q
1	4.84	274.7	212.5	11.1
2	4.84	283.8	217.9	10.7
3	4.84	283.4	215.5	10.7
4	4.84	278.0	212.5	10.9
5	4.84	284.6	212.8	10.7
6	4.84	282.7	214.3	10.8
7	4.84	286.8	217.8	10.6
8	4.83	283.5	214.8	10.7
9	4.83	281.5	217.4	10.8
10	4.84	285.8	216.4	10.6



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

8. 物料清单

父件物料 编码	父件物料描述	父件料 号版本	BOM用 途	变更编 号	可选BOM	有效起 始日期	BOM表头 文本描 述	基本数 量	基本计 量单位	BOM状态	项目类 别	组件项 目编号	组件物料 编码	组件物料描述	子件料 号版本
MATNR	MARTX		STLAN	AENNR	STLAL	DATUV	STKTX	BMENG	BMEIN	STLST	POSTP	POSNR	IDNRK	MATKL	
40	40	2	1	12	2	8	40	13	3	2	1	4	18	40	2
是	否	是	是	否	否	是	否	是	否	是	是	是	是	否	是
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		10	3100039415 CP056_WPC_FPC_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		20	3100030147 CP056_纳米晶_模切_A0_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		30	3100018789 Solder_paste锡30g/文, 供应商CTR-7790_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		40	3100039416 CP056_WPC_Mylar_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		50	3100039417 CP056_WPC_PET_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		60	3100039418 CP056_WPC_Graphite_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		70	3100039419 CP056_WPC_2D Code_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		80	3100039420 CP056_WPC_Tray (吸塑盘)_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		90	3100035250 外箱, 385x280x213mm_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		100	3100034882 面板, 350x250x3MM_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		110	3100018618 PPE袋_750*800T=0.03mm55*35	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		120	3100038251 EPE泡棉A, 260X200X10MM_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		130	3100038252 EPE泡棉B, 360X200X8mm_A0	A0
1100020966	CP056_WPC_ASSY_A0 (FAACP056M101A0)	A0	1		1	20240807		100000	EA	1	L		140	3100036880 CP055_WPC_CoilWire_A0	A0



9. 堆叠厚度

		3-5	4	1-2
材质	Layer	焊盘处	线圈处	跳线处
PET膜	PET	5	5	5
	AD	5	5	5
软板	PI	7.5		7.5
	AD	5		5
	CU Plating	10		10
	Cu layer (TOP)	25		25
	Base PI	12.5		12.5
	Cu layer (Bottom)			
	CU Plating			
	AD			
	PI			
线圈	coil	80	96	96
	Sn	10		
纳米晶	Adhesive		5	
	AD		3	
	Nano Ribbon-1		22	
	AD		3	
	Nano Ribbon-2		22	
	PSA		5	
石墨	Black PET	6	6	6
	石墨-1		70	70
	AD			
	石墨-2			
	AD			
	石墨-3			
	Black PET	6	6	6
Thickness (um)	Typical	172	248	248
	管控值	MAX270	MAX270	MAX270



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

10. 尺寸数据

 深圳市信维通信股份有限公司 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO.,LTD 尺寸检测报告 Dimension Inspection Report																								
项目 Project NO.			CP056		品 名 Product Name		无线充电模组													版 本 Rev.		A0		
生产班次 Shift					检测单号 Inspection NO.		/													日 期 Date		2024/7/11		
SPC No.	序号 No.	标称值 Std. Dim	正公差 Usl Tol	负公差 Lsl Tol	上 限 Upper	下 限 Lower	实测值 Measurement value					最大值 MAX.	最小值 MIN.	平均值 Mean	% Tolerance		Alert/Reject		判 定 Judge	量具 Gauge	备 注 Remark			
							1	2	3	4	5				Upper	Lower	High	Low						
	1	103.85	0.30	-0.3	104.15	103.55	103.913	103.887	103.875	103.906	103.927	103.9274	103.8747	103.902	26%	0%			OK	OMM				
	2	66.70	0.30	-0.3	67	66.4	66.715	66.700	66.698	66.718	66.720	66.7199	66.6977	66.710	7%	1%			OK	OMM				
	3	9.48	0.50	-0.5	9.98	8.98	9.614	9.651	9.675	9.544	9.667	9.6749	9.5438	9.630	39%	0%			OK	OMM				
	4	4.29	0.50	-0.5	4.79	3.79	4.392	4.337	4.187	4.280	4.366	4.3917	4.1874	4.312	20%	21%			OK	OMM				
	5	11.00	0.10	-0.1	11.1	10.9	10.993	10.994	10.992	10.989	10.994	10.9944	10.989	10.993	0%	11%			OK	OMM				
	6	4.00	0.10	0	4.1	4	4.021	4.023	4.028	4.026	4.026	4.028	4.021	4.025	28%				OK	OMM				

CP056 厚度尺寸测试报告						信维通信 (江苏) 有限公司 SUNWAY (JIANGSU) COMMUNICATION CO.,LTD					
Dim. No.	厚度- 1	厚度- 2	厚度- 3	厚度- 4	厚度- 5						
Nominal Dim.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
Tol. Max. (+)	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270						
Tol. Min. (-)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
USL	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270						
LSL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
Std Dev	0.0035	0.0070	0.0177	0.0177	0.0177						
Mean	0.25	0.16	0.18	0.18	0.18						
Maximum	0.261	0.259	0.184	0.220	0.230						
Minimum	0.248	0.247	0.148	0.209	0.155						
Cp	12.947	6.468	2.542	2.542	2.542						
Cpkl	24.203	7.796	3.331	3.331	3.331						
Cpku	1.690	5.139	1.753	1.753	1.753						
Cpk	1.690	5.139	1.753	1.753	1.753						
Mean Drift	0.12	0.03	0.04	0.04	0.04						
1	0.2521	0.2556	0.1636	0.2094	0.1702						
2	0.2475	0.2518	0.1643	0.2164	0.2095						
3	0.2562	0.2542	0.1596	0.2172	0.1633						
4	0.2507	0.2557	0.1518	0.2129	0.2169						
5	0.2582	0.252	0.1601	0.2115	0.1661						
6	0.2507	0.248	0.1647	0.2186	0.1647						
7	0.2563	0.2495	0.1712	0.212	0.1996						
8	0.2546	0.2591	0.167	0.2124	0.1709						
9	0.25	0.2559	0.1632	0.2132	0.1692						
10	0.2503	0.2521	0.1601	0.2117	0.1729						
11	0.2495	0.2563	0.1483	0.2126	0.2303						
12	0.2536	0.2519	0.1794	0.2176	0.1575						
13	0.2528	0.2485	0.1666	0.2171	0.1807						
14	0.2499	0.2513	0.1628	0.2133	0.1833						
15	0.257	0.2553	0.161	0.2204	0.1545						
16	0.2521	0.2552	0.1558	0.2179	0.164						
17	0.2567	0.254	0.1567	0.2155	0.1798						
18	0.2606	0.2501	0.1618	0.2152	0.1745						
19	0.2527	0.2535	0.1554	0.2175	0.1851						
20	0.2519	0.2494	0.1638	0.2111	0.1871						
21	0.2488	0.2466	0.1585	0.2152	0.1666						
22	0.2478	0.2481	0.1595	0.2115	0.1724						
23	0.2481	0.2492	0.1605	0.2178	0.1816						
24	0.2508	0.2492	0.1601	0.2126	0.168						
25	0.2491	0.2503	0.184	0.2115	0.2048						
26	0.2486	0.2555	0.1661	0.2088	0.1711						
27	0.2539	0.2472	0.1605	0.2143	0.1701						
28	0.2498	0.2568	0.167	0.2169	0.1646						
29	0.2565	0.2563	0.1567	0.2123	0.1701						
30	0.2508	0.2488	0.1689	0.2176	0.1665						
31	0.2549	0.2505	0.1617	0.2141	0.1637						
32	0.2578	0.2582	0.1664	0.2137	0.1618						



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

11. 电性规格

WPC		
Ls(uH)	Rs(mohm)	饱和电流
100kHz/1V	100kHz/1V	(标准: Ls 下降 20%)
4.83±0.15	≤300	7A



12. 变更履历

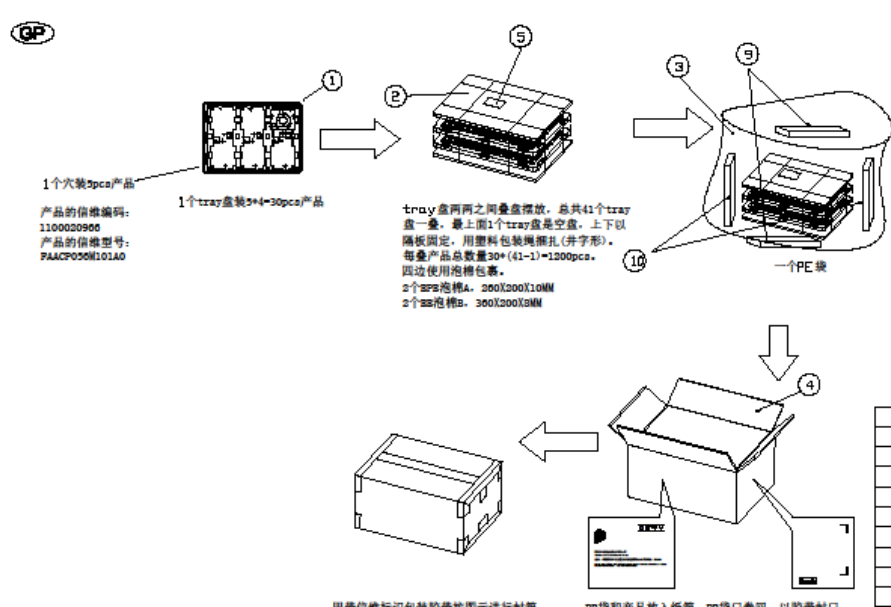
CP056项目变更说明		
变更时间	结构变更	材料变更
T0/2024.04.11	1.初版	
EVT/2024.05.16	1.设变石墨外形。 2.设变麦拉图纸。 3.微调FPC外形。	
DVT/2024.06.30	1.设变石墨外形。 2.设变麦拉图纸。 3.微调FPC外形。	
PVT、MP/2024.07.08	1.设变石墨外形。 2.设变麦拉图纸。 3.微调FPC外形。	



深圳市信维通信股份有限公司

ShenZhen Sunway Communication Co., Ltd

13. 出货包装规范

A	B	C	D	E	F																																								
◇ Process Capability Studies Required (CPK尺寸, CPK≥1.33)				Customer P/N 客户编码 NA																																									
◆ Statistical Process Capability Studies Required (SPC尺寸)																																													
 1个穴装3pcs产品 产品的信维编码: 1100020900 产品的信维型号: FAACP056M101A0 1个tray座装5+4=30pcs产品 tray座两两之间叠盘摆放, 总共41个tray座一叠, 最上面1个tray座是空盘, 上下以隔板固定, 用塑料包装地槽孔(井字形), 每叠产品总数量30+(41-1)=1200pcs, 四边使用泡棉包裹。 2个SPB泡棉A, 300X200X10MM 2个SPB泡棉B, 300X200X3MM 一个PE袋 纸筒侧面标签位置图 特殊出货时, 按包装规范使用“特殊标签”, 如尾数。 用带信维标识包装胶带按图示进行封箱, 贴好标签。 PE袋和产品放入纸箱, PE袋口卷回, 以胶带封口																																													
<table border="1"><thead><tr><th>10</th><th>SPB泡棉A, 300X200X10MM</th><th>300038252</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>SPB泡棉B, 300X200X3MM</td><td>300038253</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>泡棉顶盖/底盖</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>泡棉侧盖(黄色)</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>木箱/外箱</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>内箱标签</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Carton</td><td>300038251</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>PE bag</td><td>300038250</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Product box</td><td>300038249</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>Tray</td><td>300038248</td><td>41</td></tr></tbody></table> NO. 序号 Part Name 零件名称 Part No. 零件号 CITY 城市 NA NA NA NA THIN FILE 第三类性 SIZE 比例 M A3 SHEET 张数 1 of 1 COLOR 颜色 PROJECT 项目编码 CP056 PART NAME 零件名称 FAACP056M101A0 PART NAME 零件名称 CP056_包装 REV 版本 A0						10	SPB泡棉A, 300X200X10MM	300038252	2	9	SPB泡棉B, 300X200X3MM	300038253	2	8	泡棉顶盖/底盖		1	7	泡棉侧盖(黄色)		1	6	木箱/外箱		1	5	内箱标签		1	4	Carton	300038251	1	3	PE bag	300038250	1	2	Product box	300038249	2	1	Tray	300038248	41
10	SPB泡棉A, 300X200X10MM	300038252	2																																										
9	SPB泡棉B, 300X200X3MM	300038253	2																																										
8	泡棉顶盖/底盖		1																																										
7	泡棉侧盖(黄色)		1																																										
6	木箱/外箱		1																																										
5	内箱标签		1																																										
4	Carton	300038251	1																																										
3	PE bag	300038250	1																																										
2	Product box	300038249	2																																										
1	Tray	300038248	41																																										
<table border="1"><thead><tr><th>REV.版本</th><th>ZONE区域</th><th>CHANGE HISTOR Y 变更履历</th><th>ECN ID 变更编号</th><th>DATE日期</th></tr></thead><tbody><tr><td>A0</td><td></td><td></td><td></td><td>20240709</td></tr></tbody></table>						REV.版本	ZONE区域	CHANGE HISTOR Y 变更履历	ECN ID 变更编号	DATE日期	A0				20240709																														
REV.版本	ZONE区域	CHANGE HISTOR Y 变更履历	ECN ID 变更编号	DATE日期																																									
A0				20240709																																									